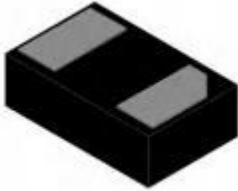
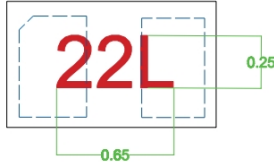
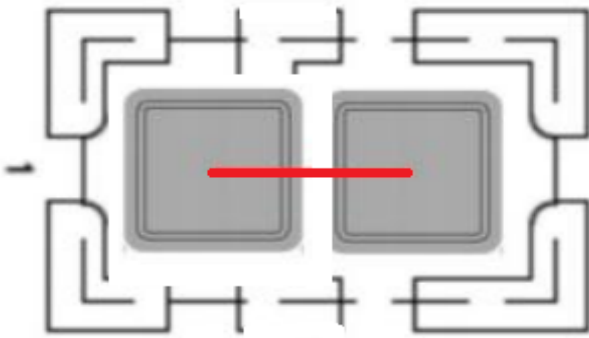


文件名称：RSUN2C121V封装资料

变更履历

版本号	变更内容	变更人	审核人	日期
V1.0	初版	罗正军	罗正军	2025.05.30

文件名称	RSUN2C121V封装资料	发布日期	2025.05.30	
		文件编号	RSUN-Y056-0002	
一、封装形式：DFN1006-2L		印 字		
		单位；MM		
				
二、晶圆说明				
晶圆名称	E022017A	晶圆尺寸	6寸	
焊盘尺寸	160um* 160um	划片道	50um	
芯粒尺寸 (含划片道)	220um* 220um	晶圆厚度	120um± 12um	
焊盘材料	Ag	背面金属	Ag	
三、胶水、焊线方式说明				
1. 两芯片需用导电胶与框架的两边基岛连接。				
2. 使用1mil 钎铜线1根，总焊线数目为1根/DIE				
3. 焊线前必须确认芯片上的焊盘与封装外引脚的功能端子一一对应。				
4 .焊线图示				
				

文件名称	RSUN2C121V封装资料	发布日期	2023.05.30
		文件编号	RSUN-Y056-0002

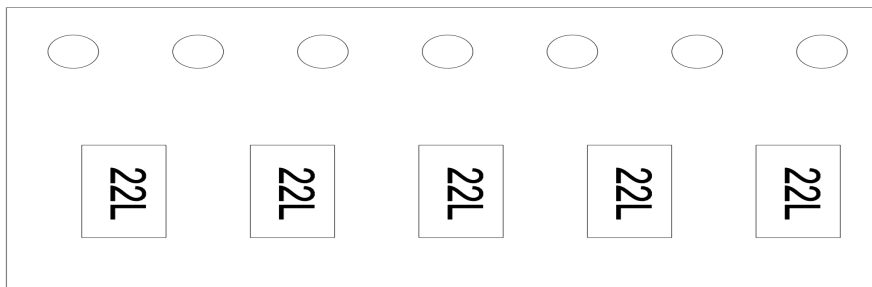
#### 四、技术要求（测试规范）

功能测试项目 (VI) 前增加 O/S 测试, 用于筛选封装不良

参数名称	符号	规范值	测试 条件
击穿电压	$V_{BR}$	15V~18	$I_R=1mA$
漏电流	$I_R$	$\leq 0.2\mu A$	$V_R=\pm 15V$

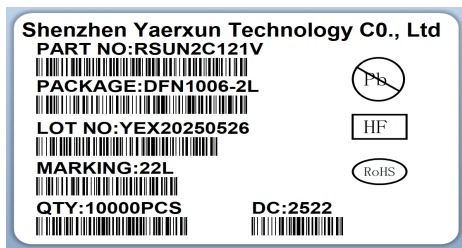
#### 五、编带方向

编带(10K/盘前后空格前100格, 后100格), 编带颜色黑色, 蓝色塑料盘, 载带定位孔位于塑料盘镂空一面。



#### 六、标签格式（以实际订单为准）

标签尺寸: 48\*80mm



#### 七、包装要求: 编带及包装要求具体参考《RSUN---包装规范A》

编制	审核	品质	客户签字	文件发行单位:
罗正军				深圳市亚尔讯科技有限公司